

GLANZOX

Silicon Polish



この写真はイメージです。This photograph is an image.

■GLANZOX

半導体デバイスの高集積化およびウェーファーサイズの大口径化が進むにつれて、シリコンの研磨面には、ナノポロジー対応を含めた、より高い平坦性、ダメージフリー、ヘイズフリー、重金属汚染フリーの完全鏡面が要求されています。これらの要求にお応えするために開発されたのがフジミグランゾックスシリーズです。コロイダルシリカを特殊組成液に分散させ、完璧な研磨面の実現を可能にしました。また近年、デバイス特性に影響する金属不純物についても厳しい低減要求がなされています。これに対し超高純度コロイダルシリカを開発し、さらに次元の高いポリシング材を用意しました。

■GLANZOX

With the increasing integration of semiconductor devices and the larger size of wafers, a damage-, haze- and heavy metal contamination free, flat, as well as nanotopography mirror-like silicon surface is essential. Fujimi's GLANZOX series was developed to meet such requirement. GLANZOX polish consists of colloidal silica dispersed in a liquid composed of special ingredients. This product results in an almost perfectly polished surface. In response to the recent demand for considerable reductions in the metal impurities that affect device characteristics, higher-grades of polish containing ultra-pure colloidal silica have been developed.

GLANZOXの代表的物性 Typical Physical Properties of GLANZOX

製品名 Type	1103	1302	1304	3500
項目 Item				
主成分 Main component	超高純度 Ultra-pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)	高純度 pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)	高純度 pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)	洗浄、保水剤
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)	17.5	18.5	18.5	—
PH	11.4	11.4	11.4	10.1
比重 Specific gravity	1.1	1.1	1.1	1.0
平均粒子径 Average particle size (nm)	35	35	9	—
用途 Application	1次 For First polishing	1次 For First polishing	1次 For First polishing	—
標準入数 Standard Net weight	17kg	10kg	10kg	10kg
ドラム Drum	220kg	220kg	220kg	200kg

製品名 Type	3900	3900RS	3101
項目 Item			
主成分 Main component	超高純度 Ultra-pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)	超高純度 Ultra-pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)	超高純度 Ultra-pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)
SiO ₂ 量 Type of product	9.1	9.1	4.5
PH	10.5	10.5	10.6
比重 Specific gravity	1.05	1.05	1.03
平均粒子径 Average particle size (nm)	35	35	35
用途 Application	Final用 For final polishing	Final用 For final polishing	Final用 For final polishing
標準入数 Standard Net weight	10kg, 20kg	10kg	10kg
ドラム Drum	200kg	200kg	200kg

GLANZOX E-Series

Silicon Edge Polish

■GLANZOX E-Series

半導体デバイスの高集積化が進むにつれて、シリコンの研磨面はますますクリーン化が求められています。ウェーファーの製造プロセスにおいて、ウェーファーの搬送およびハンドリング時の発塵防止・端面強化策としてウェーファー端面を鏡面にする必要があります。GLANZOX E-Seriesは、ウェーファー端面を鏡面に仕上げる専用のポリシング材です。コロイダルシリカをベースにし、特殊組成溶液に調製されており、高能率で研磨後の洗浄性にも優れています。

■GLANZOX E-Series

With the increasing integration of semiconductor devices, wafer surfaces must be cleaned more efficiently than ever. To prevent dusting due to transportation and handling, and reinforcement of the edge surface, mirror-finishing of the edge surface must be performed during the wafer manufacturing process. GLANZOX E-Series high-efficiency polish was developed exclusively for mirror finishing of wafer edge surfaces. It is comprised of colloidal silica dispersed in a liquid composed of special ingredients, and is superior in terms of cleanability after polishing.

GLANZOX E-Seriesの代表的物性 Typical Physical Properties of GLANZOX E-Series

項目 Item	製品名 Type	E301	E303	E304
主成分 Main component		SiO ₂ コロイダル (colloidal)	高純度 Pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)	高純度 Pure SiO ₂ コロイダル (colloidal)
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)		35	35	40
PH		11.5	10.6	11.6
比重 Specific gravity		1.24	1.24	1.28
平均粒子径 Average particle size (nm)		55	55	35
ウェーファーの種類 Kind of wafer		ベアシリコン&酸化膜 bare silicon & oxide	ベアシリコン&酸化膜 bare silicon & oxide	ベアシリコン bare silicon
標準入数 Standard Net weight		18kg	20kg	18kg、20kg
ドラム Drum		240kg	240kg	240kg